Booth #	Presentation Session	会社名	Affiliation	ハイライト(和)	ハイライト(英)
A-05	4/17 AM	DogNose センサ 技研	DogNose Sensor Lab.	「DogNoseセンサ技研」は元センサ研究者が興した生涯事業で、お客様のセンサ開発支援と、特殊センサ開発を主体に活動しています。当日は高耐久・低消費土壌水分センサと2次元風向・風量センサを展示します。	
A-07	4/17 AM	株式会社A-Co- Labo	A-Co-Labo Inc.	A-Co-Labo(エコラボ)は、企業と研究者をつなぐプラットフォームとして、外部専門家の知見を活用し、新規事業を加速します。企業が抱える事業課題に対して、適切な専門知見とその活用方法を提案し、伴走型でサポートします。 A-Co-Laboは、企業R&D出身の担当者が間に入り、実践的に進められる環境を提供できる点です。 専門知見のシェアを通じて、企業の研究開発のイノベーションを加速させましょう。	
A-12	4/16 PM	株式会社アドバン ストテクノロジー	Technologies Co., Ltd.	アドバンストテクノロジーは20年以上にわたり米国MEMS専門企業IntelliSense社の最新MEMSシミュレーション技術を国内MEMS技術者にご導入いただいておりましたが、2022年よりアルゴグラフィックスのグループ会社となり、新しい会社体制でMEMSソリューションをご紹介しております。展示ブースでは、最新プロセスシミュレーション技術からデバイス、システム解析まで対応の最新Total MEMS Solutionと電磁界解析ソフトウェアをご紹介させていただきます。	
B-01	4/16 AM	住友精密工業株式会社	Precision Products	MEMS∞は、設計からファンドリ試作、量産まで、MEMS製品化を一貫して支援します。特にPZT薄膜やSi深堀加工技術に強みを持ち、多様な材料・構造・プロセスに柔軟に対応可能です。世界水準の開発実績と高度な専門知見を活かし、初期のアイデア段階から試作、評価、量産立ち上げまで、お客様の課題解決と事業化をスピーディかつ確実にサポートします。MEMS開発の加速をお考えの方は、ぜひご相談ください。	production. Our core strengths lie in advanced PZT thin film and deep silicon etching, enabling
B-10	4/16 PM	ウシオ電機株式会社	USHIO INC.	ウシオが長年培った光源・光学技術に独自の大面積投影レンズ技術を用いたプロジェクションアライナーをご紹介致します。8インチまでのウェハをマスクと非接触で一括露光することが可能です。広い焦点深度を用い、段差や反りなど様々な形状のウェハへの露光を可能にし、プロキシミティアライナーには無い高生産性、高歩留りを達成します。	USHIO introduces full-field projection aligners that utilize our large-area projector lens and advanced optical technologies. These aligners enable one-shot exposure for wafers up to 8 inches without requiring contact with a mask. The large depth of focus ensures proper exposure of non-flat wafers with steps, warpage, or bowing, thereby achieving higher productivity and yield that cannot be attained with proximity aligners.
B-11	4/16 PM	テクノアルファ株式 会社	· ·	SPEA is a global leader in testing MEMS for over 15 years. SPEAはMEMS用ATEのグローバルリーダーです。	
B-12		田中貴金属工業株式会社	PRECIOUS METAL	Au焼結接合技術「AuRoFUSE™プリフォーム」は、焼結Auペーストを用いた、新規の接合技術で高密度実装及び高信頼性を実現します。特徴は『比較的低い温度(200℃~)、大気下で接合が可能』『圧縮変形能に優れる』『「水平方向への変形が少ないため狭ピッチ接合が可能』『接合後のアウトガスが少ない』で、フリップチップ実装への利用や、放熱性やアウトガスを嫌うデバイスへの適用が期待できます。	
B-14	4/16 AM	キヤノンアネルバ 株式会社	CORPORATION	キヤノンアネルバは、真空技術と薄膜技術をベースに開発した 真空薄膜形成装置や真空コンポーネント製品を製造、販売す る会社です。弊社展示ブースでは誘電体膜の成膜プロセスに おいて、独自の高周波プラズマ制御技術により高い安定性と再 現性を実現するカソードを 搭載したスパッタリング装置を紹介い たします。ぜひご来場ください。	

Booth #	Presentation Session	会社名	Affiliation	ハイライト(和)	ハイライト(英)
B-17	4/16 PM	株式会社 D- process	D-process Inc.	【CMP・接合 各種受託加工】試作開発から量産まで幅広く受託対応をしております。 φ12インチ〜チップサイズまで、ご要望の加工を承ります。 «対応プロセス» * CMPによる平坦化・ダマシン・表面粗さ改善等 * ウェ八接合(常温接合・プラズマ活性化接合・金属拡散接合・樹脂接合・共晶接合) * AFM測定・C-SAM測定 * 各種成膜・めっき・エッチング処理* テラス加工・トリミング加工等のエッジ処理 * 研削研磨による薄片化やダイシング等	
B-19	4/16 AM	Evatec AG	Evatec AG	Evatec の真空蒸着、スパッタリングには豊富な経験とソリューションがあり、PECVD 技術は関連する金属、誘電体、圧電体、磁性材料の成膜をサポートします。	Evatec's vacuum evaporation, sputtering have lot of experience and solutions are PECVD technologies support the deposition of relevant metallic, dielectric, piezoelectric and magnetic materials.
B-02	4/16 AM	東レ株式会社	Toray Industries, Inc.	東レの感光性ポリイミドシートLPAシリーズは、東レの感光性ポリイミド技術とシート加工技術を活かして開発された感光性接着剤フィルム(ネガ型)です。LPAは、耐熱性・絶縁性をはじめとした信頼性や加工性に優れており、層間絶縁膜、中空構造(キャビティ)形成用途などに最適です。再接着や厚膜高解像など、用途に合わせた開発も行っております。	
B-20	4/16 AM	シチズンファインデ バイス株式会社	Citizen Finedevice.,Ltd.	シチズンファインデバイスは、30年のMEMS開発経験と50年の水晶、セラミックス、光学製品の量産実績を活かし、微細加工、機能薄膜、真空封止の強み技術を組み合わせて、時計部品から電子デバイス、医療分野に至るまで幅広く製品展開しています。 MEF2025では、当社のファウンドリービジネスのコンセプト、及び近年需要が高まっているMEMS素子の真空封止パッケーサービスについてご紹介致します。	
B-21	4/16 AM	株式会社ティ・ディ・シー	TDC Corporation	株式会社ティ・ディ・シーは様々なものを精密に磨く「研磨」の技術を用いて高精度なものづくりを行っており、あらゆる材質、あらゆる形状にナノレベルの精度を実現することが可能です。単品の試作から大量生産まで幅広く対応しており、電子部品・半導体・光学・医療・航空・宇宙・自動車など様々な分野の先端技術に携わっています。また難易度の高い加工依頼に対しても、自社独自の装置開発やプロセス開発に力を入れております。また品質管理の高度化もとても重要視しており、世界最高水準の測定環境・評価技術を持つことによって、超精密ものづくりの品質保証を実現しています。MEMS分野では各種ウエハの研磨や最近ではウェハ接合も承っております。ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。	
B-22	4/16 AM	SPPテクノロジー ズ株式会社	SPP Technologies	ご存知ですか?世界で初めてBosch Process対応Si DRIE 装置が日米欧に出荷されてから今年で30年!以来、SPPテクノロジーズは技術を追求し、MEMSの進化とともに歩んで参りました。MEF2025では、Si DRIE装置だけではなく、MEMS製造プロセスに最適なソリューションをご提案します。	world's first Bosch Process-compatible Si DRIE

Booth #	Presentation Session	会社名	Affiliation	ハイライト(和)	ハイライト(英)
B-23	4/16 AM	浜松ホトニクス株式会社		浜松ホトニクスでは光デバイスにMEMS技術を融合した製品としてMEMSミラーや超小型分光器、赤外線センサなどを自社生産しております。今回、その中でMEMS技術を用いた小型近赤外分光モジュールであるMEMSファブリペロー干渉計型の小型近赤外分光器と、マイケルソン干渉計の中にMEMSミラーを採用したFT-NIRモジュールを展示します。	l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
B-27	4/16 PM	坂口電熱株式会社	SAKAGUCHI ELECTRIC HEATERS CO.,LTD.	坂口電熱は、電熱技術のプロ集団として、最適な製品とソリューションのオーダーメイドでの提供を得意としています。今般、東北大学 金森義明教授発明のAtomic-Antialiasing Annealing(AAA)技術から、【水素雰囲気アニールによる立体構造の平滑化と丸め制御新技術】を2018~2020年度サポイン事業により共同開発しました。この技術を搭載した、ミニマルレーザ水素アニール装置を【遠隔操作展示】します。加熱試験のご相談も承りますので、是非ご来場ください。	
B-28	4/16 PM	ハイデルベルグ・イ ンストルメンツ	Heidelberg Instruments	ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社は、マスクレス露光装置やマスク描画装置の開発と製造を行っている独国ハイデルベルグ・インストルメンツ・ミクロテクニックの日本支社です。本出展では弊社装置を用いて露光したサンプルや幅広い露光装置のカタログを揃えております。是非当ブースまでお越しくださいませ。	
B-29	4/16 PM	ポリテックジャパン株式会社	Polytec Japan	MEMSは、電気テストでデバイスが動作しているかどうか判断はできますが、実際の動きを測定するには、レーザドップラ振動計しか手段がありません。非接触測定が可能で、かつ、キロヘルツ、メガヘルツ、さらにギガヘルツの高周波帯域でも、ナノピコ分解能で高精度に振動を測定できるだけでなく、形状もナノメートル精度で測定できるマイクロシステムアナライザは、MEMS開発において必須のテスティングツールであると言えます。	Although electrical testing can determine whether a MEMS device is working, the only way to measure the dynamics is with a laser Doppler vibrometer. Microsystem analyzer is essential testing tools for MEMS development, as it is capable of non-contact measurement and can measure vibrations with high accuracy at nano / pico meter resolution even in high frequency bands like kilohertz, megahertz, and even gigahertz. Furthermore, it can measure not only dynamics but also topography with nanometer accuracy.
B-30	4/16 PM	ズース・マイクロ テック株式会社	SUSS MicroTec KK	インクジェットプリンティングの半導体製造への適用	Inkjet Printing for Semiconductor Manufacturing
B-31	4/16 AM	日清紡マイクロデバイス株式会社	Nisshinbo Micro Devices Inc.	日清紡マイクロデバイスは、"Connect Everything"の実現をミッションとし、超スマート社会の実現に向けて、さらなる成長と発展を図ります。本展示会場では、スマートセンシングソリューションに向けた実施例として、においセンサー、静電型MEMSマイクトランスデューサー、IoT向け湿温度センサー、高効率室内光エナジーハーベスト発電ソリューション、予兆保全用アコースティックセンサー、コネクタ嵌合音検知システムを展示し、ご紹介いたします。	Nisshinbo Micro Devices inc. is committed to its mission of realizing "Connect Everything" and strives for further growth and development toward the realization of a highly advanced smart society. At this exhibition, we will showcase and introduce various examples of our smart sensing solutions, including odor sensors, electrostatic MEMS microphone transducers, IoT humidity and temperature sensors, high-efficiency indoor optical energy harvesting power solutions, acoustic sensors for predictive maintenance, and connector mating sound detection systems.

Booth #	Presentation Session	会社名	Affiliation	ハイライト(和)	ハイライト(英)
B-32	4/16 AM	横河電機株式会 社	Yokogawa Electric Corporation	横河電機の振動式圧力センサのご紹介をいたします。産業用として製品化している電磁駆動方式の振動式センサについては、高品質な圧力制御が特長である圧力コントローラMC100と高精度圧力基準器MT300の実機展示を行います。防災用など新しい用途向けに開発した静電駆動方式の振動式センサについては、個体差が少ない2台の気圧センサをもちいて、気圧変化を打ち消して数cmの高さ変化を安定して検出する実演展示を行います。	
B-04	4/16 AM	ティー・ケイ・エス 株式会社	TKS Corporation	ヘリコンプラズマソースを用いた、リモートイオンビームスパッタリング 装置のご紹介。 ハイレート・高指向性・磁性体成膜など、 MEMS用途で活躍する最新のテクノロジーをご紹介いたしま す。	Introducing a remote ion beam sputtering system using a helicon plasma source. We will introduce the latest technology that is useful for MEMS applications, such as high rate, high directivity, and magnetic film deposition.
B-05	4/16 PM	興研株式会社	KOKEN LTD.	開放状態でISOクラス1の清浄空間を形成する オープンク リーンシステムKOACHの実機を展示します。大掛かりなクリーン ルームを建設することなくスーパークリーン空間を手に入れること ができます。不思議な気流をぜひご体感ください	
B-06	4/16 AM	BMF Japan株式会社	·	BMF (Boston Micro Fabrication) は、高精度なマイクロ3Dプリンターを製造しています。弊社のmicroArchシステムは、PµSL (Projection Micro Stereolithography) と呼ばれる3Dプリント手法を用い、製品開発、研究、産業用小ロット生産において最も正確で精密な高解像度3Dプリントを実現します。この技術は、産業界や学術研究者が品質や規模を犠牲にすることなく3Dプリントの利点を活用できるようにするもので、業界の真のブレークスルーを提供していると自負しております。	Boston Micro Fabrication (BMF) manufactures high precision micro 3D printers. The company's microArch system uses a 3D printing approach called PµSL (Projection Micro Stereolithography) to produce the most accurate and precise high-resolution 3D prints for product development, research, and industrial short run production. The technology represents a true industry breakthrough by empowering product manufacturers or academic researchers to capitalize on the benefits of 3D printing without sacrificing quality or scale.
B-07	4/16 AM	サエス・ゲッターズエス・ピー・エー	SAES Getters S.p.A.	赤外線センサー、ジャイロセンサー、圧力センサーなどの真空封止パッケージ内部の要求真空度を封止直後から維持し、性能の長期安定性を確保する、真空封止パッケージ向けゲッターをご紹介致します。また、光デバイス等の乾燥空気・ガス置換パッケージ向けに開発された、水分、水素やVOCガスを吸着可能なゲッター材の取り扱いもございます。デバイス形態・用途に合わせ最適なゲッター材を提案し、お客様の製品の長期安定化に貢献します。	We introduce getters for vacuum sealed packages that maintain the required vacuum level inside packages such as infrared sensors, gyro sensors, and pressure sensors immediately after encapsulation to ensure long-term stability of performance. We also offer getter materials that can adsorb moisture, hydrogen, and VOC gases, which were developed for dry air/gas replacement packages for optical devices, etc. We will propose the most suitable getters according to device type and application and contribute to the long-term stabilization of our customers' products.
B-08	4/17 AM	テクノプリント株式 会社		フォトファブリケーション技術で、貴社の実験・開発をサポート致します。スパッタ成膜からパターニングまでの一貫生産のみならず、各プロセス毎の対応も承ります。	
C-02	4/17 AM	第一実業株式会 社	JITSUGYO CO., LTD.	AI急拡大による膨大なデータの超高速通信が必要な時代が来ており、更なる高周波数帯域でのフィルタデバイスの普及が見込まれます。DJKはこの課題に先端技術の融合でBAWフィルタデバイスの製造革新の実現を目指し開発を推進しております。更なる高品質デバイスを低価格で製造できるソリューションを共に創り上げていきましょう。	

Booth #	Presentation	会社名	Affiliation	ハイライト(和)	ハイライト(英)
	Session				
C-03	4/17 AM	日本ガイシ株式会社	NGK INSULATORS, LTD	21世紀の世界に多くの革新をもたらし、私たちの生活をより便利で効率的なものにする可能性を秘めているMEMS技術。日本ガイシは、超精密研磨技術、異種材接合技術を用いて、高性能な次世代ウエハーを開発・提供しております。MFE2025では、アクチュエータ/センサ用PZT複合ウエハー、水晶振動子/発信器用水晶複合ウエハー、及び無線通信用LT/LN複合ウエハーをご紹介いたします。	MEMS technology, which holds the potential to bring numerous innovations to the world in the 21st century and make our lives more convenient and efficient. NGK Insulators is developing and providing high-performance next-generation wafers using ultra-precision polishing technology and multi-materials bonding technology. At MFE2025, we will introduce PZT bonded wafers for MEMS Device, quartz bonded wafers for timing Device, and LT/LN bonded wafers for wireless communication.
C-04	4/17 AM	兼松PWS株式 会社	Kanematsu PWS LTD.	Micro Point Pro社の信頼性の高いマニュアルワイヤーボンダー iBond5000は高度なグラフィックユーザーインターフェース、パラメータの外部出力と保存が可能です。またウェッジツール・ピック&プレース、ダイコレット・4探針プローブヘッドも取扱いしています。 NexGen Wafer Systems社の枚葉式スピンエッチャー・洗浄装置はウェハ表面洗浄、薄膜・金属膜エッチング、基板エッチングに使用可能で、同一チャンバー内で最大4種類の薬液を使用することが出来ます。	
C-05	4/17 AM	プラズマ・サーモ・ ジャパン株式会社	Plasma-Therm- Japan K.K.	昨今、MEMSデバイスの性能向上と微細化が進み、高集積化や一体化プロセスの要求が高まっています。そのため、高度なクリーニング技術や加工技術が必要です。弊社の高密度ラジカルクリーニング装置は微細構造を低温で洗浄し、イオン・ビーム・エッチング装置は難エッチング材や積層膜を所望の側壁角度で加工します。これらの技術の加工事例を展示会場で紹介します。	performance and miniaturization, there is an